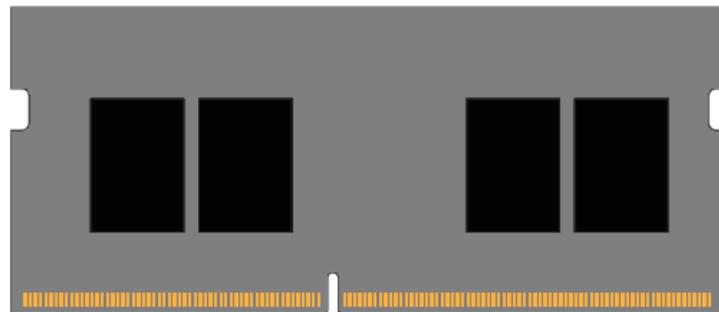
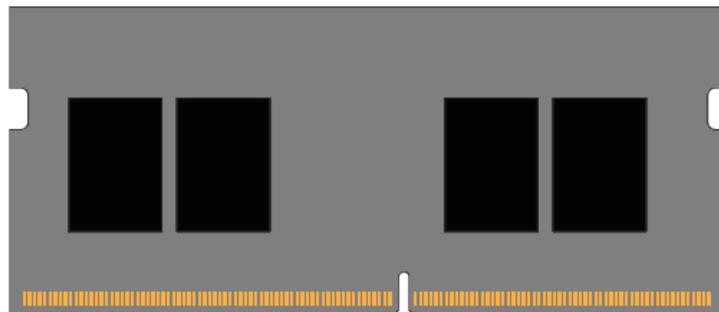
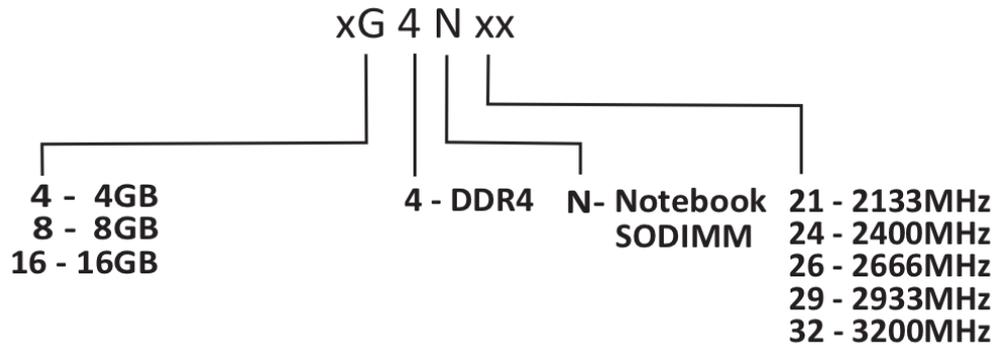


MODELOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PCB 8 Layers - 84SRCA (8 chips) / PCB 16 Layers 8ASRCE (16 chips)
- Arquitetura DDR (Double Data Rate)
- Padrão JEDEC, alimentação VDD = VDDQ = 1.2V
- "Data Strobe" bi-direcional
- Latência programável "CAS latency" (14,15,16,17,18)
- Ajuste de impedância OCD (Off Chip Driver)
- Terminação "On-Die"
- 16 bancos internos, 4 grupos com 4 bancos cada
- SPD (Serial presence detect) com EEPROM
- Dimensão padrão SODIMM 260 pinos
- Conformidade com diretiva RoHS
- Temperatura de operação 0° C até 85° C
- Contatos banhados a ouro